JP 404150027 A MAY 1992

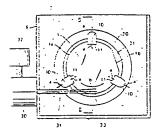
(54) CLEANING APPARATUS OF WAFER

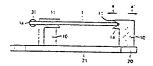
(11) 4-150027 (A) (43) 22.5.1992 (19) JP (21) Appi. No. 2-274567 (22) 12.10.1990 (71) NIPPON STEEL CORP (72) HIDEAKI KAWASHIMA

(51) Int. Cls. H01L21 304

PURPOSE: To clean an uncleaned part which has been gripped by a method wherein a wafer in a gripped state is turned by a pressure obtained by blowing a gas from a gas jet means on a part near the outer circumference of the wafer.

CONSTITUTION: A cleaning gas 7 is poured into a cleaning tank 6; a wafer 1 which has been gripped near the outer circumferential edge Ia by using three gripping members 10 arranged at equal intervals on the circumference of a circle is immersed in it; the first-half cleaning operation of the wafer 1 is executed by using the cleaning gas 7. Then, the gripping members 10 are slid in such a way that the wafer I can be turned; the wafer I is turned by a pressure obtained by blowing the jet air 33 from a jet pump 30 in the tangential direction on a part near the outer circumference of the water 1; uncleaned parts which have been gripped at the wafer can be cleaned. Thereby, the whole of the wafer 1 including the uncleaned parts which have been gripped can be cleaned effectively.





						<b>.</b> ♦.
						; #
			i.			
	·					
				·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-		
1					7:	

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平4-150027

Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4 年(1992) 5 月22日

H 01 L 21/304

3 4 1 T

8831-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

②発明の名称 ウェハ洗浄装置

②特 頤 平2-274567

図出 頭 平2(1990)10月12日

@発明者 川島

英 顕

東京都千代田区大手町2丁目6番3号 新日本製鐵株式會

社内

⑪出 願 人 新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

⑩代 理 人 弁理士 國分 孝悦

明 知 1

सार्वस्तितिस्य

1. 発明の名称

ウエハ洗浄装置

2. 持許請求の範囲

洗浄用流体が往入される洗浄槽と、

ウェハの外周近傍に接触してそのウェハを回転 可能に把持し得る複数の把持部材と、

前記洗浄用洗体が注入された前記洗浄槽内で、 前記把持部材により回転可能に把持された前記ウェハの外周近傍に気体を吹き付けてそのウェハを 回転させる気体噴射手段と、

を具備するウエハ洗浄装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体装置の製造工程において使用 されるウエハ洗浄装置に係り、特に、ウェハを l 技ずつ洗浄する枚葉式のウェハ洗浄装置に関する。 (従来の技術)

周知のように、半導体装置の製造工程において は、各工程の前処理及び後処理として、ウェハを 種々の洗浄用法体によって何回も洗浄する必要がある。このときに使用されるウエハ洗浄装置には、ウエハを 1 枚ずつ洗浄する枚葉式と、複数枚のウエハをカセット治具に収容して洗浄するバッチ式とがある。

第6回は上記枚奏式のウェハ洗浄装置の一従来 例を示すものであり、ウェハ1の外周近緒の3箇 ・ 所をそれぞれ把持具2によって把持して洗浄槽3 ・ の洗浄液4の中に投入させ、この状態でウェハ1 を浸漬或いは揺動させることによって、ウェハ1 の表裏両面を洗浄している。

### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、第6図に示したような世来の枚 葉式のウエハ洗浄装置では、洗浄中にウェハ I の 外周近傍を肥持具 2 によって機械的に肥持するの で、そのウエハ I の肥持されていた部分 P がどう しても未洗浄部分として残り、その部分 P の洗浄 状態が他の部分に比べて著しく悪いという問題が あった。

そこで本発明は、ウエハを把持して洗浄を行う

祭に、そのウェハの把持されていた部分も他の部分と同様に洗浄することができるウェハ洗浄装置を提供することを目的とする。

# (課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明による介理、小洗浄装置は、洗浄用液体が往入される洗浄槽と、ウェハの外周近傍に接触してそのウェハを回転可能に把持し得る複数の把持部材と、前記把持即構成体が往入された前記洗浄槽内で、前記把持部材により回転可能に把持された前記カッエハの外周近傍に気体を吹き付けてそのウェハを回転させる気体環射手段とを具備するものである。

#### (作用)

上記のように構成された本発明によれば、気体・環射手段によって気体がウェハの外周近傍に吹き付けられると、ウェハが肥持部材によって肥持された状態で気体の圧力により回転される。これによって、肥持部材に対するウェハの位置が変わり、よって、肥持部材により肥持されていた部分が露出される。世って、ウェハを肥持して洗浄を行う

際に、そのウェハの思持されていた未洗浄部分の 洗浄が可能になる。

#### (実施別)

以下、本発明を適用したウェハ洗浄装置の実施 例を第1回~第5回を参照して説明する。

まず、第1図~第4C図は第1実施例を示すものである。

第!回に示すように、このウェハ洗浄装置の洗浄措 5 は、ほぼ直方体状の箱型に形成され、その上面は解放されている。この洗浄積 5 内に洗浄用 液体として洗浄ガス 7 が注入される。そして、この洗浄ガス 7 内にウェハ 1 が投入される。

第1図及び第2図に示すように、ウエハ1は、 門間上で等間隔置きに配置された3個の把持部材1 0によって把持されている。これら把持部材1 0は全で同一のものであり、その前端には円弧状のソ字溝からなる把持部!1が形成されている。 そして、各把持部材10は円形の本体基板20上に取付けられ、それぞれ径方向である。なお、各把

**संक्रि**सिंद्यंग

持部財10の移動は、圏外の駆動機構によって行われる。また、本体基版20はウェハ洗浄装置の移動アーム等(図示せず)の先端に取付けられ、その本体基版20の中央部には円形の開孔21が設けられている。

そして、各把特部材10が矢のの本方向エッジ1a の近はに係合され、そのウエハ1が向下される。 を把持部は10が矢の内がにある。 また、各把持部は10が矢の内間が向している。 を把持部は1がウエックの外間に対す10が矢の内間が対す10が矢の内間が対す10が矢の内間が対す10が矢の内間が対す10が大の大きに投げられている。 をというにはないる。ないでは、一さから矢のはは、100でであり、これによりウエッのをは、100でであります。 が矢のは、100でであります。 は、100でであります。 は、100でであります。 は、100でであります。 は、100でであります。 は、100でであります。 は、100ででは、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100でには、100では、100

次に、第1図に示すように、このウェハ洗浄装置は気体電射手段を具備している。即ち、洗浄槽 5の外側には電射ポンプ30が配置されており、 この頭射ポンプ30の吐出口に接続された噴射/ズル31が、洗浄槽6の内部へ延設されている。なお、第2回にも示すように、噴射/ズル31の位置は、ウエハ1の外間エッジ1aの近傍に対してほぼ接線方向となっている。また、「噴射ポンプ30の吸入口には、空気を消浄化するためのフィルタ32が接続されている。

提って、噴射ボンブ30が駆動されると、フィルタ32によって清浄化された空気が噴射ボンブ30に導入され、その空気が噴射ノズル31から噴出空気33となって、2つの肥持部材10のほぼ中間位置でウェハ1の外周近傍に吹き付けられるように構成されている。

なお、第3図は気体項射手段の変形例を示すものであり、1本或いは2本の項射ノズル31がウェハ1の外周近傍の片面或いは両面に対して傾斜して配置されている。ごのような構成によって、項出空気33をウェハ1の外周近傍の片面或いは両面に吹き付けてもよい。

次に、上述のように構成されたウエハ洗浄装置

の動作を説明する。

まず、第1回に示す洗浄福6の外部でウェハ1が接着される。即ち、矢印a 方向へ移動された各肥持部材10の間にウェハ1が挿入され、各肥持部材10が矢印a方向へ移動されて、肥持部11がウェハ1の外周エッジ1aの近傍に係合される

この把持状態で、第4A図に示すように、ウエハーが洗浄槽6内に投入され、洗浄ガス7によってウェハーの前半の洗浄が行われる。なお、第2回に示すように、本体を板20に設けられた開孔21によって、本体を板20とウエハーとの間にも洗浄ガス7を充分に流動させることができる。

所定の洗浄が終了すると、第1図及び第2図において、各把持部材10が矢印a / 方向へ一定ストロークだけ移動され、ウエハ1が回転可能な状態となる。そして、噴射ボンブ30が駆動され、噴射ノズル31によって滑浄な噴出空気33がウェハ1の外周近傍に吹き付けられる。この噴出空気33の噴出圧力によって、第48図に示すよう

に、ウェハ1は各把待部材10によって把持された状態で矢印b方向へ回転されて行く。

なお、予め頃出空気33を吹き付けてから、ウェハ1の把持状態を使めてもよいが、こうすると、 把持状態が弛む間にウェハ1が各把持部材10に よって終られる恐れがあるので、前述したように、 予めウェハ1を回転可能な状態にした後、項出空 気33を吹き付けるのが好ましい。

東出空気33が一定時間だけ吹き付けられて、 ウェハ1が一定角度だけ回転されると、第1図に おいて、噴射ボンブ30の駆動が停止される。そ して、各把持部材10が矢印a方向へ移動され、 把持部11が再びウェハ1の弁周エッジ1aの近 傍に係合される。この把持状態で、第4C図に示 すように、ウェハ1の後半の洗浄が行われる。

以上のように、第4 A 図に示す洗浄工程の前半が終了した後、第4 B 図に示すようにウェハしを回転させると、各把持部材10に対するウェハ1の位置が変わり、それまで各把持部材10により把持されていた部分9が露呈される。従って、前

auggigg)

半の洗浄時に各把持部材 1 0 により把持されて洗浄状態が悪かった部分 P を、第 4 C 図に示す後半の洗浄時に効果的に洗浄することができる。なお、ウェハ 1 の回転時にウェハ 1 の各部分 P が再び各把持部材 1 0 に把持されないように、領出空気 3 の項射時間は予め設定されている。

なお、上述した前半の洗浄、ウェハ1の回転、 後半の洗浄の後、さらにウェハ1の回転及び洗浄 を何回繰り返してもよい。そして、最終的に洗浄 が終了すると、ウェハ1が洗浄槽6内から取り出 され、各把持部材10が矢印a1方向へ移動され てウェハ1が脱着される。

次に、第5図は第2実施例を示すものである。この例では、洗浄用液体として洗浄液 8 が使用され、この洗浄液 8 内において、取射ノズル 3 1 から清浄な項出空気 3 3 がウェハ1 の外周近傍に吹き付けられる。この第2実施例によれば、項出空気 3 3 が洗浄液 8 内で気泡項波(いわゆるパブルジェット)となるので、より強い項出圧力が得られる。

以上、本発明の実施例に付き説明したが、本発明は実施例に限定されることなく、本発明の技術 的思想に基づいて各種の有効な変更並びに応用が 可能である。

例えば、実施例では把持部材を一定ストロークだけ移動させてウエハを回転可能に把持したが、 把持部材は実質的にウエハを回転可能に把持し得るものであればよく、常にウエハを回転可能に把 持するものでもよい。また、その把持部材の構成 は各種の変更が可能である。

また、洗浄用液体としては、実液、リンス液、 純水等の液体、洗浄ガス、清浄空気等の気体を使 用することができる。さらに、ウェハに吹き付け る気体は、清浄空気以外にも各種の気体を用いる ことができる。

## (発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、洗浄槽内において把持部材によってウェハを把持した状態で、気体吸射手段による気体の吹き付けによってウェハを回転させることができる。従って、ウ

エハを配持して洗浄を行う際に、そのウェハを回 転させることによって、 把持されていた未洗浄部 分も他の部分と同様に洗浄することが可能になり、 ウェハの全体を扱めて効果的に洗浄することがで きる。

また、本発明によれば、ウエハに回転部材等を 限長的に接触させることなく、気体によってウエ ハの回転を非接触で行うことができるので、ウエ ハの摩託によるパーティクルの発生等を未然に防 止することができる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図〜第5図は本発明を適用したクエハ洗浄装置の実施例を示すものであって、第1図は第1実施例での洗浄時における装置全体の縦断面状態の正面図、第2図は第1図Ⅱ−Ⅱ線での拡大断面図、第3図は気体噴射手段の変形例における料理図、第4A図〜第4C図は洗浄時の概略図、第5図は第2実施例での洗浄時における要部の正面図である。

第6回はウェハ洗浄装置の一従来例を示す損略

図である.

なお、図面に用いた符号において、

1 ..... ... ... ... 7 I /1

§ ……………抗浄措

3 …………洗净液

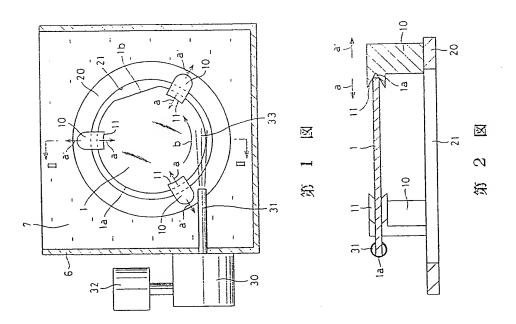
3 9 …………頭射ポンプ

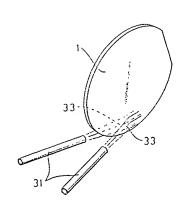
3 3 … … … … 項出空気

である.

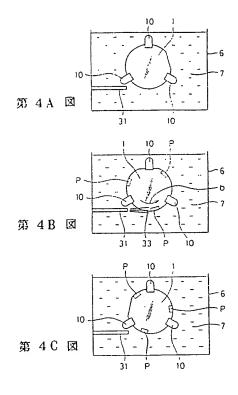
出頭人 新日本製成株式會社 代理人 弁理士 國分孝悦

agnapa

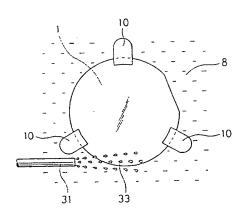




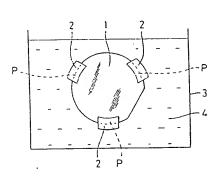
第 3 図



эворба



第 5 図



第 6 図

क्षुक्षक्षेत्रहेत्। -

30

: